

## 长电科技 2023 年度、2024 年第一季度业绩

### 暨现金分红说明会记录

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）10:00-11:30 通过进门财经电话会议、上证路演中心转播及网络文字互动方式召开了 2023 年度、2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司董事/首席执行官（CEO）郑力先生、独立董事李建新女士、首席财务长徐阳先生、董事会秘书吴宏鲲先生等相关人员就公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，以及 2023 年度利润分配情况的具体情况与近 340 位机构及个人投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者提出的问题及公司回复情况如下：

1、2023 年海外营收同比下滑较多，比行业跌幅更大，具体有些什么因素导致这样的变化？是否因为特定的应用市场或者是某些客户的影响？也注意到我们一季度营收表现很好，能否展开讲这部分同比的表现？

星科金朋在 20-22 年实现了比较好的业务增长，在 22 年半导体行业步入下降周期时，仍实现了 17% 的同比收入增长。

星科金朋去年的下滑主要是海外客户去年开始进入下行周期，但在周期底部时间相对较短。去年下半年，公司海外客户的收入已经实现同比正增长。

从行业上看，在其有较好布局的并在 22 年有大幅成长的计算类及工业模拟市场客户订单有所下滑，但同时汽车业务也有快速增长。工业模拟类需求在今年第一季度逐步回暖，库存调整结束的倾向已经显现。

今年第一季度星科金朋整体已实现收入同比增长，相信随着下半年更多行业步入复苏，星科金朋整体业绩相比去年将继续快速恢复。

2、关于跟数据中心用到的电力相关的封装类产品的增长，能否大概量化预估在未来可能会达到怎样的量级，能够对我们带来怎样的贡献？

高密度电源从先进封装角度来讲是一个非常有意思的新兴的市场。除了现在大家关注的算力和存储，我觉得高密度的供电是个瓶颈，急需解决方案。这块公司在两年前已经注意到并积极布局，发挥我们在高密度的系统级封装积累的多年

技术能力。今年在市场方面可以看到，所有的算力中心用在 AI 主板上，集成供电管理芯片上的密度和用电的密度越来越高，GPU 的耗电水平呈现指数级增长。今年以先进封装的形式做高密度供电的业务量跟去年相比将增长数倍，而且这一趋势才刚刚开始并持续扩大。我们非常有信心来支持全球的主流厂家，向客户提供数据中心高密度供电的先进封装服务。

3、台积电一季度法说会，对全球晶圆厂市场的增速有下调，想请教公司，展望二季度及今年全年来看整体景气度，并从下游拆分来看一下？

我们也看到了国际大晶圆厂对原来他们预期的市场增速做了一定的调整，市场下调到 10% 左右。这个问题我们是这样看的，一方面我们自身从去年的预估来看是渐入佳境的，所以原来我们对市场的看法和第三方预测机构的看法还是不太一样，我们觉得 10% 是比较现实的，也符合我们自己预期的增速。另一方面，从晶圆厂的预测来看是没有包括存储的，但是从我们的市场看，存储市场今年的回暖非常明显。高密度存储是我们现在继续发力并非常看好的市场，我们持续加强和西部数据的战略合作。结合来看，我们对今年二季度继续成长及下半年的继续发展还是比较乐观和有信心的。综合不同的晶圆厂和产业的应用领域来看，还是维持比较积极的预测。

4、在先进封装包括 2.5D 和 3D 封装的市场关注度比较高，请教领导，对于先进封装未来整体的市场格局是怎么样的判断？

因为先进封装在整个市场的发展过程中起到越来越重要的作用。一方面晶圆厂对于先进封装的支持力度越来越大，另一方面现在市场上主流封装厂将先进封装作为必选项加大投入，同时也有很多新兴企业瞄准了 2.5D 和 3D 的封装加入到市场。总体我们觉得这是水涨船高的格局，大家都能够积极的加入进来。以晶圆厂的角度，从我的理解和沟通看，主流的晶圆厂在积极的支持，因为和晶圆上的 TSV 和晶圆处理的关系越来越紧密。但是先进封装本身对整个晶圆厂是个锦上添花的业务，并不是最主流的业务，所以将来肯定会形成封装厂的分工，趋势已经越来越明显，即使在今天某些先进封装产能短缺的情况下，这样的分工也势在必行并已经发生。同时我们也认为针对先进封装所需要的投入是非常的大，开

发的周期非常的长，由于先进封装所处理的芯片价值非常的大，所以大的客户在做最先进的封装时会非常的谨慎，往往会选择有长期的实力，有非常强的长期开发工程的能力和资金能力的供应商，一起推动和开发先进封装技术及产品。主流的封装厂，具有丰富的封装技术积累，也有比较强的资金和研发的实力，也会在未来先进封装市场的发展中起到越来越主要的作用。

5、存储行业前期复苏，我们近期也看到存储不管从颗粒的原厂还是下游的模组厂的业绩大幅回暖，公司在存储行业有比较大的业务，未来也会收购晟碟。请教一下，目前来看我们是否有看到存储的量价回暖趋势？在存储业务方面特别是收购晟碟以后我们的布局是怎样？

存储在全球半导体产业来看是值得高度关注的话题，我们已经很明显的看到存储的闪存和 DRAM 及一些细分存储产品的国际和国内客户恢复的趋势，出现供不应求及涨价的情况。晶圆厂及存储厂恢复产能的扩充，对新技术和研发的投入都非常积极。从另外一个角度看到存储产业今天的回暖不仅是因为前面两年周期性的产能及库存调整，与整个半导体产业趋势回暖相一致；同时更深厚的背景是 AI 的驱动。大家看到 AI 的主芯片周围配备高密度的存储的芯片，内存的芯片，与 GPU 和 CPU 相比有成倍的增加。对存储的程序和内容的读取需求都是大幅度增长。这与存储本身内容从文字到视频到更加丰富的内容的增长有相当大的关系。所以我们非常看好存储市场的增长，已经超出了正常半导体的一般性的周期的回暖，受到 AI 驱动未来会有巨大的成长。所以我们和西部数据这样全球顶尖的存储厂家的合作，并通过并购的业务，实现了走向全球的战略及对国内的高密度闪存的需求非常好的推动。闪存走向高密度的时候也要采取先进的封装形式，以实现更高的带宽和速度的提升。这块技术的发展让我们感到非常的兴奋，积极推动全球存储技术的发展。

6、公司在汽车电子的发力是非常的显著的，最近台积电在法说会上对全球的汽车产业今年的需求做了微弱的下调，刚才提到公司汽车业务在下半年需求应该会好转，想问全年对汽车整个行业，包括中国大陆的市场的预期是怎样的？是否会因为头部晶圆厂口径的变化，对预期有新的调整？

汽车电子市场从两方面来看，确实前两年新能源汽车很多新的企业加入进来有提前消费的感觉，之前国内市场销量很好。所以到了今年，包括国际头部新能源汽车车厂都在做面向市场调整的动作。如同王传福先生所说的：“新能源汽车的市场上半场是看电池，下半场要看芯片”。因为新能源汽车走向了智能化，对芯片的复杂度，对芯片的要求越来越高。在新能源汽车下半场看芯片的浪潮将是比较持久的趋势，而且不仅仅是在中国而是在全球市场。因为智能化不仅是以新能源汽车为驱动，也包括混动和燃油车的，智能化是车厂继续向前发展的重要方向。对芯片企业，在产品的可靠性，电性能要求比任何一个其他的应用都要严格，进而对封装的要求也是非常的高。所以在整体的市场的需求的角度，及对先进封装和复杂封装的需求的“质”和“量”都有非常明显的持续的的增长的趋势，所以我们对今年汽车电子芯片封装需求的增长是非常有信心的，并维持长期的增长趋势。并不会因为短期的新能源汽车的生产量的波动，而有非常直接的影响。

7、去年至今公司业绩持续增长，但毛利率呈现波动上行趋势，后续对于毛利率是怎样的展望？

目前半导体市场仍处于复苏的早期，力度有限，客户的价格压力依然存在，加上淡季的原因，产能利用率还没有完全恢复到我们前期的水平。我们今年第一季度毛利率比去年同期是有所增长的，净利率比去年也有所增长。我们会持续在国内外研发中心和各工厂加大研发投入，提升我们的产品先进性，提升盈利水平。同时我们在去年积累的降本增效经验会继续加强我们毛利率水平，有望实现逐季提升。

8、去年原本规划的资本支出 65 亿，最后购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金只花了大约 31 亿，是什么原因呢？今年的 60 亿预计会用在哪儿？

去年实际支出资本开支金额小于年初的规划，一部分是因为市场需求原因，有意放缓投资节奏，另外我们设备下单金额大于现金付款，部分会在今年到货后支付。今年投资主要集中在先进封装，测试的扩产及 2.5D 研发投入。

9、STATS CHIPPAC PTE. LTD. 在报告期营业收入 160,191.72 万美元，是包含了星科金朋半导体（江阴）、SCS 新加坡厂、SCK 韩国厂的营收吗？

年报上所披露的 STATS CHIPPAC PTE. LTD. 在报告期营业收入是包括这三个工厂的营收：星科金朋半导体（江阴）、SCS 新加坡厂、SCK 韩国厂。

10、对今年第二季度跟全年的营收展望？

第二季度我们将力争实现收入及利润的环比正向增长。我们预计第一季度是公司盈利的低点。全年公司将力争实现逐季度的业绩成长，紧抓行业的成长机遇。

11、请问一下贵公司在账面有大量货币资金的同时还在进行债权融资进行银行借款，截止 2024 年一季度加上理财，银行存款加交易性金融资产已经将近 120 亿，公司大量积累货币资金是近期有大量的资金使用计划吗？

考虑到公司的长远发展和当前所处的扩张成长阶段，我们需为资本开支和研发投入继续投入资金，确保业务结构的持续优化和创新动能的培育。公司计划 2024 年固定资产投资人民币 60 亿元，除此之外还有近期股权收购支付等需求。

12、请问晟碟半导体去年的营收是多少？

晟碟半导体去年上半年收入为 16.1 亿元。

13、新投资的上海的汽车电子公司预计什么时候能产生效益？

预计公司项目 25 年初完成建设，并在 25 年内投产。

14、所收购的晟碟半导体何时并表？对原有收入的贡献率有多大？

如果过程顺利，按照目前的计划将在下半年实现 80% 股权的交割并实现并表，根据具体交割时间的不同，收入贡献有所不同。

15、公司在存储市场和人工智能方面有什么新的举措？

长电科技针对高性能计算系统推出了一站式解决方案，具有完整的专利技术布局，全套设备产能支持，和持续更新的技术产品路线图，覆盖了计算，存储，

电源及网络相关芯片的封装需求。在计算领域，长电科技已经于 2021 年推出了多维扇出封装集成的 XDFOI®技术平台，并持续推进多样化方案的研发及量产，以及在海内外工厂的相关产能布局，可覆盖当前市场上的主流 2.5D Chiplet 方案。对于存储领域，长电科技具备超薄芯片封装，助力系统的小型化解决方案。持续加大在高密度存储技术研发投入，同时公司推出的 XDFOI®高性能封装技术平台可以支持高带宽存储的封装要求。公司已于近期宣布收购晟碟半导体（上海）有限公司 80% 股权，旨在进一步加强公司在存储领域的技术及产能布局。并在国内和国外的工厂继续加强和全球头部厂家项目的合作，包括今年开始长电微对先进存储产能将有明显的释放。对于高性能计算发展所带动的电源管理需求，长电科技具备完备的功率器件封装技术和量产经验，覆盖碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等新材料功率器件及多种分立和芯片级封装，并在散热和可靠性上拥有多项专利技术，开发了多种散热结构。通过与头部用户紧密合作，公司已在服务器供电模块技术及制造上积累了丰富的经验。对于网络模块，长电科技与国内外客户就 CPO 光电合封产品进行了多年的技术合作。